

笔记本CPU升级全攻略 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/136/2021_2022__E7_AC_94_E8_AE_B0_E6_9C_ACC_c98_136664.htm 在着手升级CPU之前，我们应当先讨论一下笔记本专用CPU（Mobile CPU）的封装问题，这是升级的前提，同时也是升级成功的关键。结构分析传统意义上的封装形式对于芯片仅仅是一个外壳，是机械结构性的保护；然而现阶段芯片的封装除了结构特性外，还包含了散热机制，并成为了电性能上芯片与主板连接的平台。进一步说，封装的复杂性很大程度上取决于芯片的结构特性和设计方法。对CPU这种复杂的芯片而言，其封装的技术更加复杂。由于封装的意义在于最大限度的保障CPU发挥它的最佳性能和提供一个与主板的连接平台，因此封装的性能和结构，是实现笔记本专用CPU体积小，散热快，功耗低等各项特性的保证。CPU的高速发展，对笔记本电脑的体积、散热、功能等限制无疑是一种挑战。作为笔记本电脑专用CPU，为了满足上述要求，也只好从封装来做文章了。一般而言，采用什么样的封装形式往往取决于各个时代CPU的技术和成本等因素。对笔记本电脑来说，由于其结构空间紧凑狭小，因此它的体积直接影响到笔记本电脑的厚度和空间利用率；它的散热效果直接影响到机器运行的稳定性；它的功耗则影响到笔记本电脑电池的使用时间。这些技术指标与笔记本电脑CPU所采用的封装形式是息息相关的，所以，封装技术对于笔记本电脑专用CPU而言，是一种很重要的技术体现，这也就是在我们给笔记本电脑CPU升级之前，必须首先考虑封装问题的原因。与台式电脑一样，笔记本专用CPU

的封装形式也因各代CPU的不同而不同。下面列举几种常见的笔记本电脑专用CPU的封装形式，以供升级时参考。（介绍将从Pentium MMX开始，再此之前的386和486级别的Mobile CPU时至今日已经没有升级的意义，所以不再介绍。部分使用AMD和TM移动式CPU的产品数量少，因此也不在本文讨论范围之内）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com